

第 27 回宇宙用部品連絡会アジェンダ

日時： 平成 24 年 11 月 16 日（金） 13：15～16：30
場所： 東京：JAXA 東京事務所 4F 401、402、403 及び 404 会議室
筑波：つくば宇宙センター 総合開発推進棟 2F 小会議室 3
（東京⇄筑波テレビ会議設定）

- 1.開会の挨拶
- 2.部品ユーザからの情報 (13：15－13：40 25分)
 - ・ NEC 東芝スペースシステム(株)
- 3.部品メーカーからの報告 (13：40－14：15 35分)
 - 3.1 スタックコンデンサの開発及び工程の集約について (株)福井村田製作所)
 - 3.2 抵抗器の材料変更 (多摩電気工業(株))
 - 3.3 チップ形タンタル固体電解コンデンサの加速寿命試験結果報告 (松尾電機(株))
- 4.部品生産のスケジュールに関して (14：15－14：35 20分)
 - 4.1 チップ形タンタル固体電解コンデンサ (松尾電機(株))
 - 4.2 POL の状況報告 (日本アビオニクス(株))
 - 4.3 パワー-MOSFET の状況報告 (富士電機(株))
- 5.QPL/QML 部品認定状況、その他活動報告 (14：35－14：45 10分)
 - 5.1 共通部品等の認定状況
 - 5.2 QTS/ADS の改定状況
 - 5.3 認定部品の変更管理状況
- ◆休憩◆ (14：45－15：00 15分)
- 6.JAXA からの報告 (15：00－15：20 20分)
 - 6.1 部品ロード・マップ
- 7.海外情報 (15：20－15：50 30分)
 - 7.1 海外宇宙機関 関連情報
 - 7.2 G12/11 報告
 - 7.3 インプラントレビュー報告
 - 7.4 ESCC /JAXA 試験要求の比較について
- 8.部品クラス分けに関するディスカッション (15：50－16：20 30分)
- 9.その他 (16：20－16：30 10分)
 - 9.1 今年度の行事及び予定
- 10.閉会の挨拶